



Marking - engraving laser system.
Système de gravure et marquage laser.

BIG SMARK

VERSATILITY

Increased functionality of the laser source allows for **engraving, marking** and **microcutting** to meet the highest technical standards available.

WIDE WORK CHAMBER

The **500 x 500 mm** work chamber (maximum piece height 530mm with F100 focal lens) is easy to access thanks to the door that opens on three sides.

FLEXIBLE SYSTEM

It can be integrated with all Sisma accessories as well as the **Coaxial Vision System** and the **Pattern Matching** software.

ADVANCED SOFTWARE

Entirely developed by Sisma, the **integrated software** is the ideal solution for file management and parameters defining, even for **complex jobs**.

FLEXIBILITÉ

Les fonctionnalités accrues des sources laser permettent la **gravure, le marquage** et la **micro découpe** pour répondre à toutes les demandes standards ou de hautes précisions.

LARGE CHAMBRE DE TRAVAIL

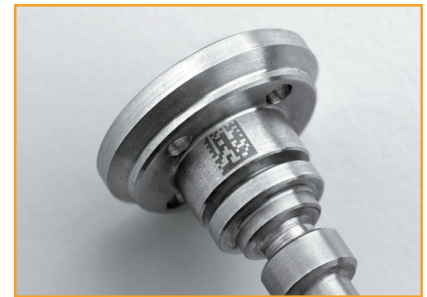
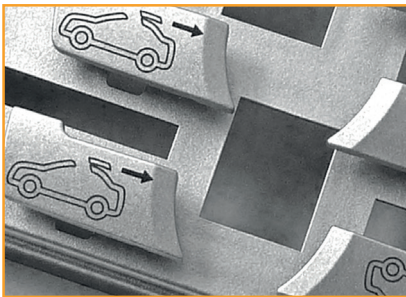
La chambre de travail de **500 x 500 mm** (hauteur maximum de la pièce 530 mm avec F 100 focale) accès facile grâce à la porte qui s'ouvre sur 3 côtés.

SYSTÈME FLEXIBLE

Il peut être intégré tous les accessoires Sisma ainsi que le **Système de Vision Coaxiale** et le logiciel de **Pattern Matching**.

LOGICIEL AVANCÉ

Entièrement développé par Sisma, le **logiciel intégré** est la solution idéale pour la gestion des fichiers et la définition des paramètres, même pour des **travaux complexes**.



Technical Data - Données technique

	200F	200F EP	300F	400F	500F	700F	1000F	GREEN	UV
Laser source - Source laser	Yb	Yb	Yb	Yb	Yb	Yb	Yb	Nd:YV04	Nd:YV04
Wavelength - Longueur d'onde	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm	532 nm	532 nm	355 nm
Average laser power - Puissance moyenne	20 W	20 W	30 W	40 W	50 W	70 W	100 W	10 W	3 W
Pulse frequency - Fréquence d'impulsion	1÷500 kHz	1÷1000 kHz	1÷500 kHz	1÷1000 kHz	1÷500 kHz	1÷500 kHz	CW÷1000 kHz	1÷300 kHz	1÷300 kHz
Pulse duration - Durée d'impulsion	260/40 ns	3-500 ns	260/40 ns	10-240 ns	250/40 ns	260/40 ns	17/500 ns	30 ns	35 ns
Max pulse energy - Energie par impulsion	1/0,21 mJ	0,03-1 mJ	1/0,21 mJ	0,16-1,33 mJ	1/0,21 mJ	1/0,21 mJ	0,1/1 mJ	0,25 mJ	0,075 mJ
Beam quality - Qualité du faisceau laser	≤ 1,6 M ²	≤ 1,6 M ²	≤ 1,6 M ²	≤ 3,5 M ²	≤ 1,6 M ²	≤ 1,6 M ²	≤ 1,6 M ²	≤ 1,2 M ²	≤ 1,3 M ²
Laser spot diameter - Diamètre du spot laser	20 µm	20 µm	20 µm	40 µm	20 µm	20 µm	20 µm	12 µm	7 µm
Max marking speed - Vitesse de marquage max.	2000 mm/s					5000 mm/s		2000 mm/s	
Focal lenses - Focales	F100, F160 (standard), F254, F330							F100, F160	F160
4 th axes - 4 ^{ème} axes	Optional								
Guide laser - Laser guide	Class 2M Red Laser Diode; λ=650 nm; 2 mW								
Working temperature - Gamme de température	10°C to 35°C - non condensing								
Cooling system - Système de refroidissement	Forced-air cooling						Water	Forced-air cooling	
Working chamber - Zone de travail	500 x 500 x 380 mm								
Power supply - Alimentation électrique	230 V ± 15% 50/60 Hz 1ph 0,8 kW								
Dimensions (WxDxH) - Dimensions (LxPxH)*	650 x 1040 x 1760 mm								
Weight - Poids	640 kg								

The features, images, performances, weights and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice. Les caractéristiques, les images, les performances, les poids et les mesures sont purement indicatives et approximatives et peuvent changer sans préavis.

05/2017



SISMA S.p.A.
via dell'Industria 1, - 36013 Piovene Rocchette (VI) Italy
tel. (+39) 0445 595511 - fax (+39) 0445 595595
info@sisma.com - www.sisma.com

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
ISO 9001**